

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的策略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本文件所述[編纂]中位數），經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們估計將收取[編纂]淨額約[編纂]港元（相等於約人民幣[編纂]元）。根據我們的策略，我們擬將[編纂]按下述金額用於下述用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計將用於新建一個生產基地。我們擬在於2025年10月收購的地盤面積為74,801平方米的舟山物業建造新生產基地，詳情請參閱「業務－物業－自有物業」。此項目的總估計投資額預期介乎人民幣[編纂]元至人民幣[編纂]元。我們擬透過自身資金及／或其他融資來源撥資餘下項目成本。具體而言：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計將用於新建一個生產基地有關的建築開支。預計包括(a)工程及建設費用、(b)裝置費及(c)其他建築相關費用以及應急儲備，以彌補與項目有關的潛在成本超支及意外開支；
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計分配為新生產基地採購及安裝設備與機器；
 - (iii) [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於項目初始營運資金支付人工和材料成本，以支持新生產基地的初始營運期。

於完成後，新建立的生產基地旨在為若干新產品提供產能。擬於舟山生產線製造的產品為我們現有產品組合的延伸，主要包括(i)功率模塊及車規級組件；(ii)為支持功率模塊及車規級組件而共同開發的配套中低壓MOSFET產品；及(iii)專為滿足汽車應用更高可靠性標準而設計的功率模塊及車規級組件。該等產品擬憑藉我們的既有專業知識，基於我們現有的功率半導體工藝平台進行開發。功率模塊及車規級組件專為與我們的功率器件無縫配合而設計，具備寬泛的電壓範圍、高電流容量、強抗干擾能力及內置保護，從而提升整體系統效率及可靠性。配套的MOSFET產品經共同優化，以匹配該等模塊的性能。該等新產品主要針對汽車電子市場，並基於我

未來計劃及[編纂]用途

們現有的功率半導體平台以及我們在目前終端市場的佈局，包括可再生能源逆變器、工業驅動器及儲能。我們的車規級組件亦符合AEC-Q100等嚴格標準，具備寬溫耐受性、抗電磁干擾能力以及在嚴苛的汽車環境中長期運作的耐用性。根據灼識諮詢的資料，汽車電子是功率半導體器件行業最大的下游應用領域。2025年中國汽車功率半導體市場規模達人民幣456億元，佔整體功率半導體市場約41.8%。這亦是較成熟的應用領域中增長最快的，預計2026年至2030年的複合年均增長率為12.1%，這乃由於新能源汽車朝著高壓電動化及更高智能化方向發展，帶動每輛汽車使用的功率器件數量及價值不斷增加。此外，根據灼識諮詢的資料，2025年中國汽車功率半導體的本土化率約為20%，預計到2030年將超過50%。鑒於預期的市場增長前景及加速的本土化趨勢，我們認為對國產功率模塊及車規級組件將存在巨大需求，預計這將有助於支持我們舟山生產基地產能的利用率。

在工藝層面上，與我們珠海生產基地的現有生產線相比，開發功率模塊及車規級組件所需的封裝及測試工藝在無塵室等級、工藝精度及電磁干擾控制方面有著大幅更高的要求。此外，該等產品所需的封裝技術涉及一種有別於我們珠海工廠目前所採用工藝的製造方法，珠海工廠是在晶圓級別以單裸片為基礎進行WLCSP封裝。相比之下，將於我們舟山生產基地生產的功率模塊及車規級組件需要系統級封裝，這是一種基於組裝的方法，將一個或多個芯片集成到單一基板上以形成一個集成模塊。對於車規級產品，我們的舟山生產基地將進行額外的可靠性測試，以滿足AEC-Q100等嚴格的汽車標準。舟山工廠專為提供適用於功率模塊及車規級組件的系統級封裝而設，而我們的珠海工廠無法提供該等技術支持。鑒於該等差異化工藝流程，設立專用設施對於實現穩定的大規模生產具有重要技術意義，並將提升我們在核心製造階段的產能與能力，從而增強我們供應鏈的自主性、穩定性及長期韌性。

- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於加強研發能力及撥資關鍵研發項目。為了在更廣泛的WLCSP市場的高增長細分領域中抓住新興機遇並滿足未來需求，我們擬進一步加強我們的產品組合並提升我們產品的功能。我們計劃加大在技術創新方面的投入，重點在於新能源汽車領域的新一代產品及新一代功率半導體器件的開發，以及針對CSP以外的廣泛下游應用（如工業控制、AI服務器及工業級無人機等）的研發工作，提升我們產品的技術水平並保持我們的行業領先地位。具體而言，我們的目標應用

未來計劃及[編纂]用途

場景涵蓋工業控制領域的光伏及儲能逆變器、工業逆變器及伺服電機驅動器；AI服務器應用場景中的大功率、高可靠性GPU/CPU電源單元、伺服器電源模塊及數據中心冗餘電源系統；以及工業級無人機領域中農業、巡檢及物流無人機的電子調速器、飛控及電源管理模塊。具體而言：

- (i) [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於購買研發材料，如襯底、外延、MO源和靶材以支持我們的核心研發計劃，包括新一代功率半導體器件的開發、AI服務器及工業級無人機等用於工業控制及新能源汽車應用的高可靠性系列產品的開發，及現有產品的技術迭代。我們的新一代新能源汽車產品將我們的車規級MOSFET產品及技術擴展至更高集成度的產品形態，以用於功率模塊及車規級組件，並結合定制的系統級優化，為客戶提供更高價值；
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於挽留、擴大及加強我們的研發團隊。為滿足採用我們產品的下游應用不斷增長的需求，我們計劃於未來幾年額外吸引及挽留約100名具備半導體領域專業知識、學位及／或背景的研發人員，從而不斷提升我們的研發能力；
 - (iii) [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於測試及驗證費用。
- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於審慎進行戰略投資及收購。我們的主要目標是尋求具有互補性的技術、產品或人才，以擴大我們的市場範圍並鞏固我們在高增長行業的地位。

在評估潛在目標時，我們擬採用一套全面的甄選標準，專注於戰略協同效應、技術能力、商業化往績記錄及財務紀律。我們的主要考慮因素包括：

- (i) **戰略與技術互補性**：我們將優先考慮技術成熟的目標，以補充我們現有的產品組合。我們的重點領域包括車規級功率模塊、工業應用的先進MOSFET以及氮化鎵等第三代半導體技術。具體而言，我們將專注於最近一個財政年度產生的研發費用不少於人民幣10.0百萬元的目標公司。我們將專注於擁有強大知識產權組合的目標公司，並已證明有能力開發符合嚴格行業可靠性標準的產品，如車規級(AEC-Q101)認

未來計劃及[編纂]用途

證，包括那些擁有不少於15個註冊核心專利或同等專有技術的目標公司。此舉將有助我們加強技術能力，特別是在新能源汽車及可再生能源系統的高壓及大功率應用方面。

- (ii) **客戶與渠道的協同效應**：我們將物色可讓我們接觸新主要客戶及銷售渠道的目標公司，尤其是領先的汽車一級供應商及主要可再生能源設備製造商，在這些方面我們有發展機會。我們將優先考慮客戶基礎互補的目標公司，以最大限度地拓展市場並避免內部競爭。
- (iii) **團隊專長及商業化能力**：我們將重視目標公司管理及研發團隊的質素及經驗。我們將尋找具備良好往績記錄的團隊，如於領先的國際半導體公司有約10年的經驗，並具備將複雜產品（特別是車規級器件）由設計階段發展至成功量產的全棧經驗。
- (iv) **財務合規及風險管理**：任何潛在的投資或收購均須經過嚴格的財務評估。我們將鎖定在收入增長及盈利能力方面擁有良好往績記錄，並已證明能抵禦行業低迷的公司，包括於往績記錄期間年收入不少於人民幣150.0百萬元。我們擬採用嚴謹的估值方法，並可能考慮各種交易結構（包括有董事會代表的少數股權投資或全面收購），以調整激勵措施並確保戰略監督。

截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體的投資或收購目標，我們亦未就該等交易訂立任何最終協議。根據灼識諮詢的資料，市場上有超過20家亞洲潛在目標公司符合我們的選擇標準。

- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]淨額多於或少於預期（包括因(i)[編纂]設定高於或低於[編纂]中位數的[編纂]；或(ii)行使[編纂]的額外[編纂]淨額），我們將按比例調整[編纂]淨額的分配以用作上述用途。

倘我們發展計劃的任何部分因政府政策變動等原因導致我們任何項目的開發不可行或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃進行，我們將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂]淨額。

倘[編纂]淨額並未即時用作上述用途或我們無法按預期實施計劃的任何部分，以及在相關法律及法規准許的情況下，我們僅會將該[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律及法規）的短期計息賬戶。於此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。